

IEE-차세대반도체혁신융합대학 공동워크숍

공동워크숍 지원서				
성명	<i>홍길동</i>	본교학번	<i>21618111</i>	
소속대학	<i>대구대학교</i>			
연락처	<i>010-1234-1234</i>	이메일	<i>gilldong@daegu.ac.kr</i>	
지원자격	<i>별첨 1 참조</i>			
재학증명서 취합하여 첨부				
차세대반도체 수업 수강이력	<i>뉴로모픽의 이해 반도체 개론 머신러닝</i>			
지원사유	<i>반도체 기업으로의 취업을 희망하고 있어, 현재 차세대 반도체 융합대학의 마이크로디그리도 이수 중에 있으며, 이번 행사의 참여를 통해 반도체 기업 취업 트렌드와 취업을 위해 어떤 준비를 해야하는지 알아보고 싶어 지원을 하게 되었습니다.</i>			
관심 참여기업 (‘O’ 표시)	삼성전자 LSI	<i>O</i>	딥엑스	
	SK하이닉스		스카이칩스	
	시놉시스코리아		FURIOSAAI	
	퀄컴코리아	<i>O</i>	오픈엣지테크놀로지	
	LG전자		네메시스	
	ETRI	<i>O</i>	텔레칩스	<i>O</i>
	KETI		네패스	
	사피온코리아		에이직랜드	
	에이디테크놀로지		픽셀플러스	
	실리콘마이터스		케이던스코리아	
	비전넥스트		보스반도체	
	LX세미콘			